

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-05-002

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 </p>
<p>参与单位</p>	<p>招商证券、招商致远资本、Fubon Life、Fuh Hwa SITC、Manulife AM、Millennium Capital、Nomura、Polymer Capital、Schroders、Tokio Marine、Rays Capital、马可波罗、西南证券、广发基金、中信证券、博时基金、南方基金、中信保诚基金、九泰基金、淳厚基金、平安理财、拓璞基金、朱雀基金、华安基金、英大国际信托、南方天辰投资、仁桥资产</p>
<p>时间</p>	<p>2022年5月23日——26日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、王渝、肖晓月</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p> 一、公司简介 公司成立于1993年，持续28年深耕线路板产业链，从PCB样板起家，2012年开始进入IC封装基板领域，2015年通过收购美国HARBOR和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统PCB到半导体测试板、IC封装基板的产品、技术和客户升级。自2018年起公司开始步入产能扩张阶段，前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入 </p>

规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。

未来公司将继续保持战略定力，推动广州兴科 IC 封装基板项目的投资扩产及广州 FCBGA 项目的投资建设，并积极提升自身的能力以应对宏观经济层面的不确定性和行业层面的竞争压力。

二、公司经营情况简介

2021 年度，公司实现了 2010 年上市以来最大的扣非净利润增长幅度，经营情况与业绩快报预计基本一致，实现营业收入 503,998.71 万元、同比增长 24.92%；归属于上市公司股东的净利润 62,149 万元、同比增长 19.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,097.82 万元、同比增长 102.46%；总资产 830,221.83 万元、较上年末增长 34.69%；归属于上市公司股东的净资产 376,238.41 万元、较上年末增长 14.38%。

2022 年第一季度，公司经营情况与业务预告预计基本一致，实现营业收入 127,247.69 万元、同比增长 18.82%；归属于上市公司股东的净利润 20,108.33 万元、同比增长 98.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,109.08 万元、同比增长 10.56%；总资产 876,402.42 万元、较上年末增长 5.56%；归属于上市公司股东的净资产 396,868.38 万元、较上年末增长 5.48%。

2022 年第一季度，公司整体收入规模保持增长态势，扣非净利润受公司 2021 年员工持股计划费用摊销、广州兴科 IC 封装基板建设项目及公司筹建的 FCBGA 封装基板项目的人工成本等因素影响（合计超 2,000 万元），增速有所放缓。

三、公司产能及规划介绍

PCB：2021 年度，广州生产基地产能为 39.66 万平方米/年；宜兴生产基地产能为 40.70 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4 万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为 1.5 万平方米/月，其中 7,000 万平方米/月产能已达产，后续产能将继续逐步释放；小批量产线在广州生产基地和宜兴生产基地，非公开发行项目主要是宜兴生产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分期建设投产。

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 HARBOR、广

州科技。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已实现满产满销，整体良率保持在 96%左右；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科，由全资子公司珠海兴科实施）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，第一条产线（1.5 万平方米/月）已于 2022 年 4 月开始试生产，预计 6 月份开始进入小批量生产阶段，今年年底实现单月 90%以上的产能利用率目标。之后再分批建设 3 万平方米/月的产能，初步计划在 2023 年底前建成投产。

FCBGA 已启动项目建设前期准备工作，同步启动设备采购工作，计划 2023 年底前后进入试产阶段。

四、公司各业务毛利率情况介绍

2021 年度，公司 PCB 印制电路板实现收入 379,432.60 万元，毛利率为 33.13%、同比提升 0.56 个百分点；半导体测试板实现收入 41,687.12 万元，毛利率为 20.34%、同比下滑 6.35 个百分点；IC 封装基板实现收入 66,653.49 万元，毛利率为 26.35%、同比提升 13.35 个百分点。

公司 PCB 印制电路板业务因产品结构、经营模式而具备一定的议价能力，原材料价格波动产生的影响相对较小，叠加公司精益生产、降本增效等措施及扩产产能的释放，实现盈利能力的平稳增长。

半导体测试板业务 2021 年毛利率同比下滑主要原因是上海泽丰不再纳入公司合并报表；随着广州基地产能的逐步释放，交期和良率指标的改善，将有望提升盈利能力。

IC 封装基板业务毛利率受限于目前产能规模及前期设备、人工、研发等投入，未来随着产能逐步释放及调整产品结构，提升高端产品占比等措施，将进一步提升盈利能力。

五、公司样板下游应用及客户情况介绍

公司经过二十多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，在样板行业成功树立了多品种、小批量、快速交付的品牌形象，具有一定的品牌效应。公司目前活跃客户超过 4,000 家，客户集中度低。公司客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，客户所涉行业较广，不依赖单一行

业或单一客户，受下游大客户或单一行业周期影响小，样板下游应用包括通信、计算机、服务器、安防、光模块、工控等领域。

六、IC 封装基板下游应用及客户情况介绍

存储类载板是 BT 载板领域最大的下游市场，也是公司目前主要目标市场。公司目前 IC 封装基板以 BT 类载板为主，FCBGA 封装基板项目尚未投产，下游占比为：存储类占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关占比约 1/3，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况为：大陆客户占比约 2/3，中国台湾客户和韩系客户合计占比约 1/3，下游大陆厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

七、下游应用领域未来景气度预判

从产品结构看，呈现结构分化的增长趋势：高端产品的景气度较高，中低端产品随着产品更新迭代和技术升级，需求会相对弱一些。根据 Prismark 的预测，未来五年增速最快的领域是 IC 封装基板和多层板领域。从应用领域看，服务器领域是今年景气度最高的下游行业，对宜兴硅谷有较大贡献；通信行业的增长情况取决于 5G 推动的进度，宜兴硅谷已突破通信行业大客户的 5G 认证，未来形势向好；安防、工控、轨道交通等行业的增长相对平稳；医疗方面目前虽因疫情影响市场景气度较好，但从长期看表现平稳；汽车电子方面，总量没有大的增长，结构会从传统汽车转向新能源汽车。受 5G、AI、大数据、物联网、智能驾驶等领域快速发展的拉动，芯片需求量持续增长，高端芯片的紧缺程度持续提升，作为核心材料的 IC 封装基板未来几年的增速会显著高于 HDI 板、多层板、纸基板、双面板和 FPC 等产品。

八、定增项目的计划

公司定增项目已经接触了不少有认购意向的投资者。目前公司 2021 年利润分配方案已经过股东大会审议通过尚未实施，根据相关法规规定，利润分配实施完毕前不得发行，因此预计将在分红实施完毕之日起至 2022 年 10 月定增批文有效期届满之日视情况择机发行。

附件清单

无

日期

2022 年 5 月 23 日——26 日